



H6165 有机硅光学胶

H6165 是一种单组份，UV 与加热双重联合固化机制的有机硅材料。产品设计为防止湿气和大气污染，提供长期密封保护的高性能封装材料。特别适用于光学粘结，Mini LED 等。

产品描述

常规性能

条目	指标	测试标准
外观	无色透明粘稠液体	目测
粘度 cps	5000	GB/T 10247
密度 g/cm ³	1.0	GB/T 13354
折射率	1.53	阿贝折射仪

产品优点

- **高硬度**
形成韧性高硬度硅胶，水汽透过率低。
- **耐候性**
优异的耐 UV 性能，在-45°C~150°C范围性能长期保持稳定。
- **高透明**
超高的光学透明。
- **粘接性**
和 PET、PPA 等材料粘结良好。
- **绝缘性能**
优异的绝缘性能，保护元器件在高压环境中正常工作。
- **操作简单**
单组分，无需混合，设备投入小。
- **环保**
无溶剂，无固化副产物。



产品操作

操作工艺

在操作期内浇注到需灌封的产品上，抽真空去除气泡，然后根据固化条件固化即可。

项目	典型值	单位或条件
可操作时间	3	月
UV 固化方式 1	3000-5000mJ/cm ²	365nm LED UV
UV 固化方式 2	800-1500mJ/cm ²	UVA 250-340nm
热固化条件	100-150°C/60min	UV 照射后再进行热固化
透明度	99	%

注意：①操作时间实际上在黄光室和保存期差不多 ② UV 光照射以后需要加热 100 度固化 60 分钟

典型性能

性能条件

条目	测试标准	典型值	单位/备注
硬度	ISO868	30	ShoreD
导热系数	GB/T 10297	0.2	W/mK
膨胀系数	GB/T 20673	200	μm/m·°C
吸水率	GB/T 8810	0.01	% (24h, 25°C)
介电强度	GB/T 1693	20	kV/mm (25°C)
损耗因素	GB/T 1693	0.01	@1MHz (25°C)
介电常数	GB/T 1693	< 3.0	@1MHz (25°C)
体积电阻	GB/T 1692	1.0×10 ¹⁵	Ω.cm (DC500V)

注：以上数据都在完全固化后测定所得

操作注意事项

1. 产品取用后应注意密封保存。
2. 可以采用点胶工艺，也可以采用钢网印刷工艺。
3. 浇注到产品上再次抽真空去除气泡，可提高固化后产品的综合性能。
4. 温度过低会导致固化速度偏慢，如有需要可加热固化。
5. 本产品与含 N、S、P 等元素的化合物以及一些重金属 (Sn、Pb、Hg、Bi、As) 离子化合物接触，会出现难固化或不固化的现象。



标准包装

- 18kg /桶

产品储存及运输

需避光、避热、密封保存

本产品无毒性、无危险性，遵循普通化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在阴凉、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：8~25°C，保质期：3个月

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com